

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-078

大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司产品研发进展的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	大唐高鸿网络股份有限公司
奕斯伟	指	北京奕斯伟计算技术股份有限公司
C-V2X	指	Cellular-V2X, 蜂窝车联网, 指以蜂窝网络(4G/5G)技术为技术基础的一种车载V2X通信方案
SoC	指	系统级芯片
TSMC	指	台湾积体电路制造股份有限公司
JDV Review	指	指JOB deck view, 是芯片流片前的最后一次审查核对
MPW	指	多项目晶圆
ADAS	指	高级驾驶辅助系统

一、产品研发情况

(一) C-V2X 芯片产品基本情况

依据 C-V2X 标准, 车联网无线通信技术(V2X)是实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和云(平台)等全方位连接和通信的新一代信息通信技术。V2X 通信包括车与车之间(V2V, Vehicle-to-Vehicle)、车与路之间(V2I, Vehicle-to-Infrastructure)车与人之间(V2P, Vehicle-to-Pedestrian)、车与网络/云(平台)之间(V2N, Vehicle-to-Network)/(V2C, Vehicle-to-Cloud)等的通信。其中, V2V、V2I 和 V2P 具有低时延、高可靠等特殊严苛的通信要求, 而 V2N 没有严格的时延与可靠性要求。汽车与交通行业应用车联网技术的目的是提高驾驶安全、提高交通效率、降低总能耗, 最终与 ADAS 协同实现自动驾驶。C-V2X 芯片, 是用来满足上述功能的专用通信芯片。

(二) 产品研发进展情况

2023 年公司与奕斯伟联合开发 C-V2X 芯片(以下简称: “车联网芯片”), 现双方 C-V2X SoC 芯片联合团队的车联网芯片设计开发工作已完成, 奕斯伟已将

所负责部分的阶段性成果全部交付给公司。公司近期收到的通知，TSMC 已完成 C-V2X 项目 JDV Review, 确认车联网芯片已进入 MPW 生产阶段。

二、对公司的影响

2023 年底在 C-V2X 原型机上打通 First call, 近期完成整个车联网芯片的 SoC 设计并流片, 将为公司车联网业务的持续发展夯实基础并提供动力, 同时标志着公司的 C-V2X 芯片商业化量产节奏在加速, 有利于增强公司核心竞争力, 巩固公司在相关领域的市场竞争力。此车联网芯片处于样片流片阶段尚未正式投产, 尚未产生收益。

三、风险提示

本次推出的产品仍存在技术风险和市场风险, 未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素, 公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况, 请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2024 年 06 月 25 日